

## ATM-3000EF

全自動ウェーハ表面保護テープ  
ドライレジストフィルム貼り機  
Automatic Wafer Lamination System

## 【概要 - Outline -】

- ◆本装置は、ウェーハ裏面研磨工程前のウェーハ表面の保護テープの貼り付け及び、バンプ工程でのウェーハ表面への  
The ATM-3000EF is the ideal system for laminating tape to wafers, for the backgrind process and dry resist film lamination process.  
ドライレジストフィルムの貼り付けを全自動で行う装置です。

## 【特長 - Features -】

- ◆ウェーハカセット部とメンテナンス部に仕切りを設け、メンテナンス部をクリーンルーム  
State-of-the-art design to maintain the integrity of the lamination area and to achieve the best footprint.  
外に設置することにより、高クリーン度の必要な室内のスペースを小さくすることができます。
- ◆重量化対策を配慮し、テープ交換作業は装置背面からできる設計としました。  
Ergonomic design for optimum access to operator areas and service areas on the system
- ◆テープテンション自動調整機能付きです。  
Tape stretch data control.
- ◆対話方式による簡単操作。  
Ease of operation
- ◆FOUP カセット対応 (オプション)  
FOUP option
- ◆AGV、OHT 通信機能対応可 (オプション)  
AGV and OHT protocol options
- ◆8・12 インチ対応機  
Applicable to 8" and 12" dia-wafer
- ◆ヒーターローラー、ヒーターテーブル標準装備  
Heater roller and heater table are applicable



仕様 Specification	ATM-3000EF	
スループット Throughput	42 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	8・12 inch	
使用テープ幅 Tape Width	8 inch : W 225 mm / 12 inch : W 330 mm	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC100V 単相 Single phase 60Hz 4.0KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.4Mpa 100NI/min
	真空源 Vacuum source	- 80 Kpa
装置寸法 Demension	W 1,350 × D 1,625 × H 1,800 mm	
重量 Weight	600 kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。  
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.